

Montageanleitung HEATKILLER® CPU Rev3.0



Die HEATKILLER® CPU Rev3.0 - Serie setzt neue Maßstäbe im Bereich Leistung, Qualität und Montagefreundlichkeit. Die Entwicklung der neuen High-End Prozessor Kühlerfamilie wurde konsequent auf die aktuellen CPU-Generationen ausgerichtet.

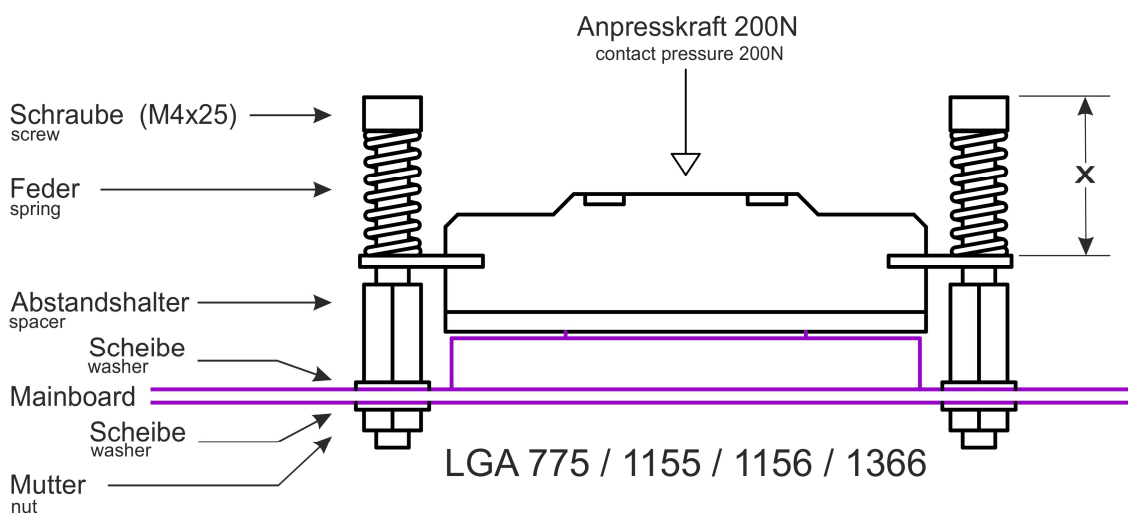
	HEATKILLER® LC	HEATKILLER® LT	HEATKILLER® CU
Abmaße (LxBxH)	60 x 59 x 17mm	60 x 59 x 17mm	60 x 59 x 17mm
Gewicht	140g	140g	390g
Material (Boden/Deckel)	CU / POM	CU / POM	CU / CU
Material (Halterung)	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Anschlüsse	G ¼ Zoll	G ¼ Zoll	G ¼ Zoll
Temperaturfest bis	80°C	80°C	95°C
Kompatibel zu	AMD LGA 754 / 939 / 940 / AM2(+) / AM3(+)		
	INTEL LGA 775 / 1156 / 1155 / 1366 / 2011		

1. Montage auf Sockel 775 / 1155 / 1156 / 1366

1.1 Montage des CPU Kühlers

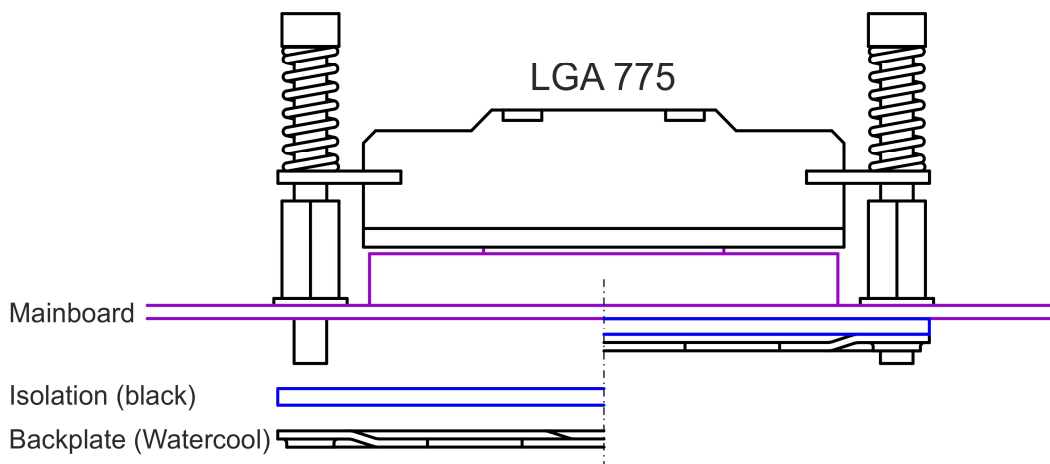
Im Laufe die Erstinstallation muss das Mainboard ausgebaut werden, für nachfolgenden CPU - Wechsel ist ein weiterer Ausbau nicht mehr erforderlich. Vor der Installation des HEATKILLER CPU-Kühlers ist der Prozessor gleichmäßig mit einer Wärmeleitpaste zu versehen. Die Montage erfolgt analog zur untenstehenden Abbildung, dabei ist zu beachten, dass die mitgelieferten Unterlegscheiben nicht vergessen werden. Nach der Befestigung der vier Abstandshalter können diese mit einem Ringschlüssel (Größe 7) angezogen werden. Die Schrauben (M4x25) werden nun mit einer Druckfeder versehen und in den Abstandshalter geschraubt. Alle vier Schrauben sind gleichmäßig (über Kreuz) und ohne Kraftaufwand einzuschrauben. Nähere Angaben zur Einschraubtiefe (X) entnehmen Sie bitte der Federkrafttabelle.

Achtung: Bei einigen Sockel 1366 Mainboardtypen muss der Kühlkörper um 90° gedreht montiert werden, damit die Kondensatoren (linksseitig neben dem CPU-Sockel) den Kühler nicht berühren.



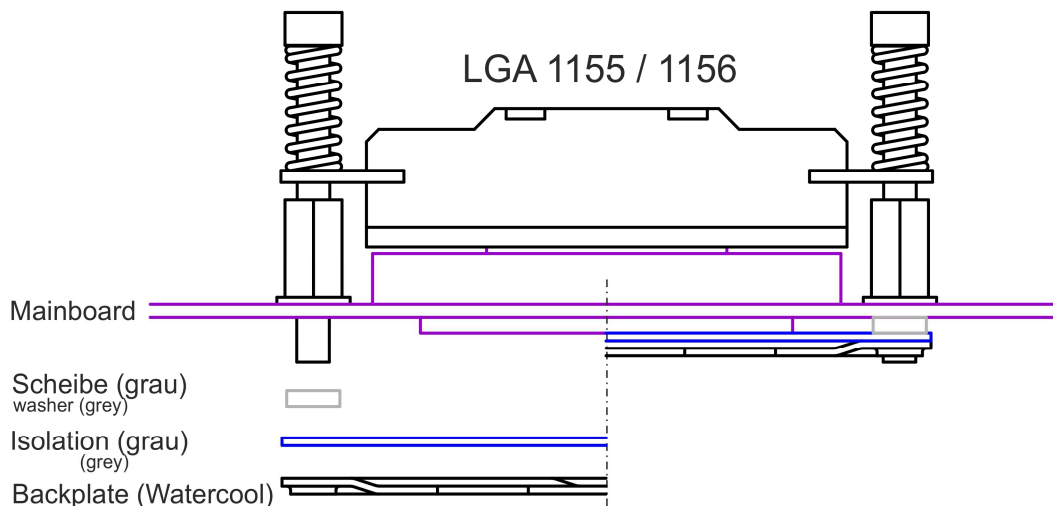
1.2 Montage der Watercool Backplate auf Sockel 775 (optional erhältlich)

Statt der beim HEATKILLER® CPU Rev3.0 mitgelieferten M4 Schrauben, werden die Abstandshalter in den Gewinden der Backplate fixiert. Zum Lieferumfang der Sockel 775 Backplate gehört ein X-förmig zugeschnittenes Isolationsmaterial. Dieses muss unbedingt zwischen Mainboard und Backplate gelegt werden. Nach erfolgreicher Montage muss der Watercool Schriftzug zu lesen sein.



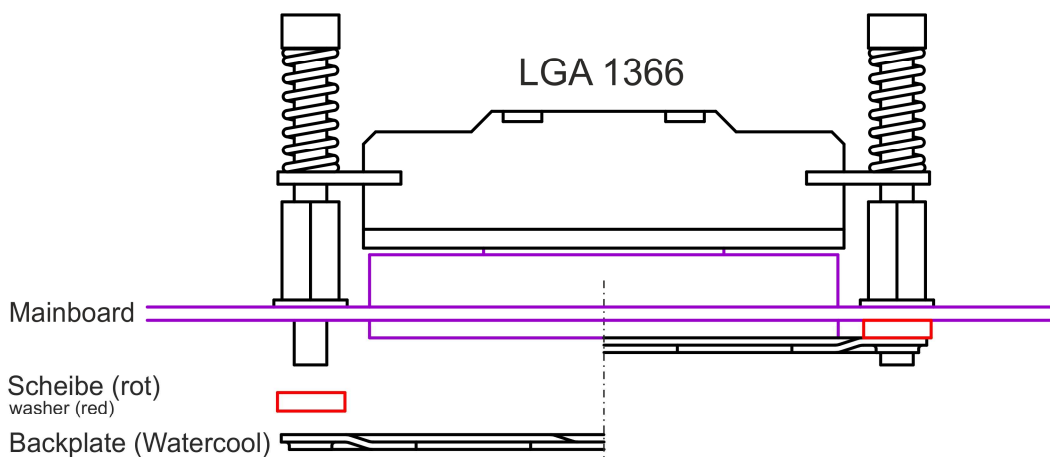
1.3 Montage der Watercool Backplate auf Sockel 1155 / 1156 (optional erhältlich)

Statt der beim HEATKILLER® CPU Rev3.0 mitgelieferten M4 Schrauben, werden die Abstandshalter in den Gewinden der Backplate fixiert. Im Lieferumfang der Sockel 1155/1156 Backplate befinden sich vier hohe Unterlegscheiben, diese müssen an der Mainboardunterseite zusammen mit der beiliegenden Isolierung angebracht werden. Nach erfolgreicher Montage muss der Watercool Schriftzug zu lesen sein.



1.4 Montage der Watercool Backplate auf Sockel 1366 (optional erhältlich)

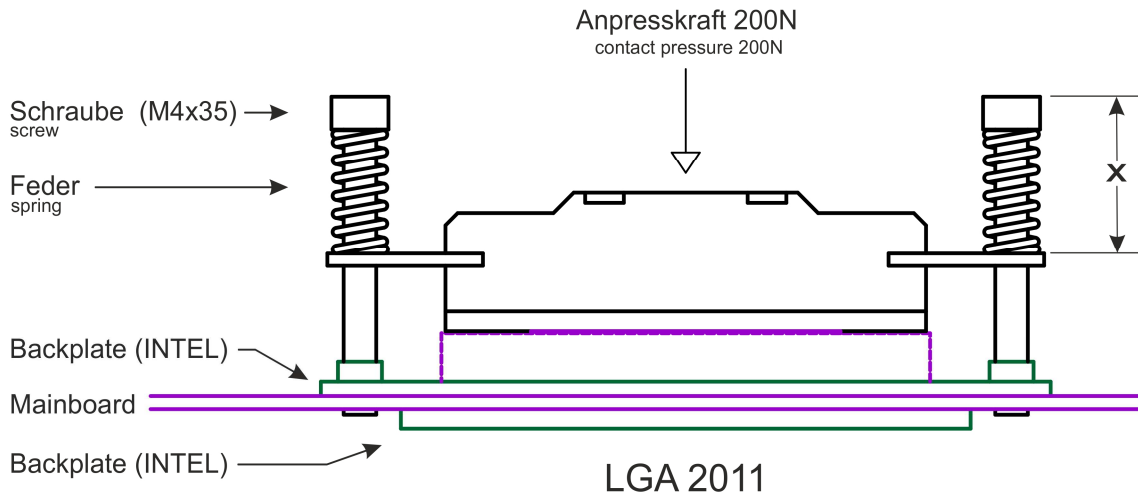
Statt der beim HEATKILLER® CPU Rev3.0 mitgelieferten M4 Schrauben, werden die Abstandshalter in den Gewinden der Backplate fixiert. Der Sockel 1366 Backplate liegen vier rote Distanzringe bei, diese müssen zwischen die Mainboardunterseite und der Backplate montiert werden. Nach erfolgreicher Montage muss der Watercool Schriftzug zu lesen sein.



2. Montage auf Sockel 2011

Vor der Installation des HEATKILLER CPU-Kühlers ist der Prozessor gleichmäßig mit einer Wärmeleitpaste zu versehen. Die Schrauben (M4x35) werden nun mit einer Druckfeder versehen und in die auf dem Mainboard vorhandene Backplate geschraubt. Alle vier Schrauben sind gleichmäßig (über Kreuz) und ohne Kraftaufwand einzuschrauben. Nähere Angaben zur Einschraubtiefe (X) entnehmen Sie bitte der Federkrafttabelle.

Hinweis: Bei der allerersten Montage sind die Schraubenlöcher vom Sockel u.U. noch mit einer Isolationsfolie verdeckt. Hier kann beim Durchstoßen dieser Folie ein Knackgeräusch auftreten.

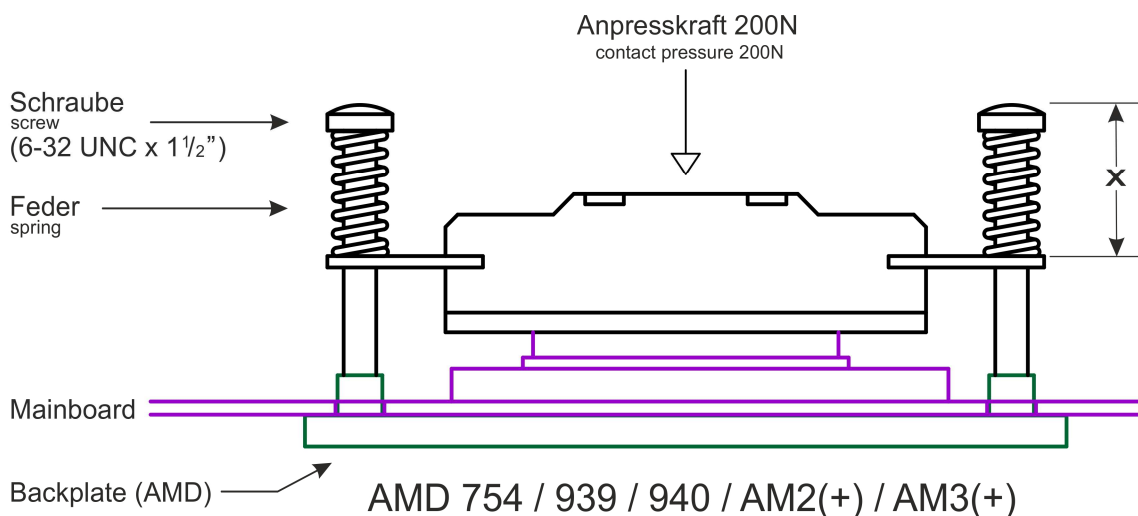


3. Montage auf Sockel 754 / 939 / 940 / AM2(+) / AM3(+)

Vor der Installation des HEATKILLER CPU-Kühlers ist der Prozessor gleichmäßig mit einer Wärmeleitpaste zu versehen.

Die Montage erfolgt analog zur untenstehenden Abbildung. Die Schrauben werden mit einer Druckfeder versehen und in die Backplate geschraubt. Alle vier Schrauben sind gleichmäßig (über Kreuz) und ohne Kraftaufwand einzuschrauben. Nähere Angaben zur Einschraubtiefe (X) entnehmen Sie bitte der Federkrafttabelle.

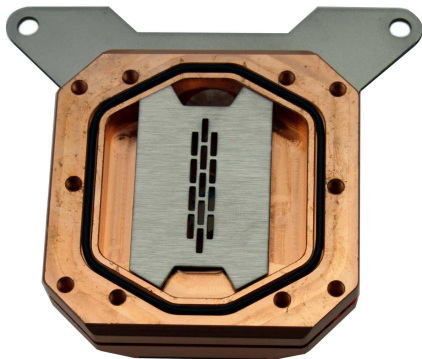
Falls die Backplate nicht herstellerseitig mit dem Mainboard verklebt wurde, kann dieses auch im Nachhinein mit doppelseitigem Klebestreifen durchgeführt werden. Mit Hilfe der Klebestreifen bleibt die Backplate auch nach der Demontage des Kühlers in Position.



Federkrafttabelle	0 N	100 N	150 N	200 N	250 N
INTEL (alle Sockel)	23,0	21,3	20,5	19,6	18,7
AMD (alle Sockel)	16,0	14,3	13,5	12,6	11,8

Entscheidend für die Kühlleistung ist die Anpresskraft, als Empfehlung dient die nachstehende Tabelle. Die Einschraubtiefe (X) wird, wie in der Grafik beschrieben, ermittelt. Am besten eignet sich dazu ein Messschieber. Das Maß wird von der Oberseite der Schraube bis zur Oberseite der Halterung gemessen. Wir empfehlen eine Anpresskraft von 200N.

4. Nachträgliche Umrüstung auf einen anderen Sockel



Ihr HEATKILLER® CPU Rev3.0 kann nachträglich auch auf einen anderen Sockel umgerüstet werden. Zu diesem Zweck sind Umrüstkits separat erhältlich.

Zuerst muss die Bodenplatte entfernt werden. Dazu müssen die 6 Inbusschrauben (SW 2,0) auf der Unterseite des Kühlers gelöst werden. Danach ist der Blick auf das Innenleben Ihres HEATKILLER® CPU Rev3.0 frei. Im nächsten Schritt lösen sie die 4 Inbus-Madenschrauben in den Ecken des Kühlers. Der dafür benötigte Inbusschlüssel (SW 1,5) gehört zum Lieferumfang des Umrüstkits. Dadurch werden die Halterungen gelöst und können herausgezogen werden. Setzen Sie anschließend die neuen

Halterungen ein und ziehen sie die Madenschrauben wieder fest. Beachten Sie bitte, dass die glänzende Edelstahlseite der Halterung in Richtung der Anschlussseite des Kühlers zeigt. Ziehen Sie danach die 4 Madenschrauben wieder fest. Nun können Sie die Bodenplatte wieder montieren. Achten Sie dabei unbedingt darauf, dass die Düsenplatte und der O-Ring wieder korrekt sitzen. Sollte die Düsenplatte verkantet kann die Bodenplatte irreparabel beschädigt werden. Überprüfen Sie dringend vor erneuter Inbetriebnahme des Systems den Kühler auf Dichtheit.

5. Konfiguration für Ein- oder Mehrkernprozessoren (betrifft nur LGA775)

Die neue HEATKILLER® CPU Rev3.0 – Serie (außer LC-Version) kann einfach auf die verschiedenen CPU-Typen umgestellt werden. In der Regel sind alle Kühler schon entsprechend vorkonfiguriert.

Die steckbare Verteilerplatte aus Kunststoff sorgt bei LGA775 Quadprozessoren (zb. Intel Core 2 Quad), die aus zwei Dualprozessoren bestehen, für eine optimale Anströmung.

Bei Prozessoren, die nur aus einem Die aufgebaut sind (zb. Core i3, i5, i7, Phenom, Bulldozer), ist die Verteilerplatte nicht notwendig.

Die Verteilerplatte wird einfach mittels einer schmalen Zange in den Aufnahmeschlitz (Kühleroberseite, im mittigen Anschlussgewinde) gesteckt, bzw. wieder entfernt.

6. Allgemeine Hinweise

Alle Kühler der HEATKILLER® CPU Rev3.0 – Serie haben einen definierten Ein- und Auslass. Der Eingang befindet sich immer zentral in der Mitte des Kühlers.

Wir empfehlen demineralisiertes bzw. entionisiertes Wasser (destilliertes Wasser) als Kühlmedium zu verwenden. Zum Algenschutz kann handelsübliche Zitronensäure verwendet werden, ein Ausbreiten von Algen wird so wirkungsvoll verhindert.

HEATKILLER® sind Produkte von

WATERCOOL
quality cooling equipment

Watercool e.K

Zum Mevenbruch 6
D-17192 Waren OT Warenschhof
GERMANY

Tel: (+0049) 03991-187601

Fax: (+0049) 03991-187602

Bitte senden Sie Kritik, Lob oder Anregungen an folgende Adresse:

E-Mail: info@watercool.de

Web: www.watercool.de